

出展のご案内

第36回 エレクトロテスト ジャパン

拝啓

師走の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

さて、弊社は表記展示会にて、下記製品を中心にご紹介させていただく運びとなりました。次世代自動車技術の本格化やウェアラブル端末の開発が進み、半導体デバイスは、超小型化・高性能化が進んできました。新たな部品や技術が続々と開発され、リークテストへの要求も年々高まっております。フクダでは、市場のニーズに合せた製品開発を進めています。会場では、半導体業界やウェアラブル業界に向けたリークテスト装置をご紹介いたします。つきましては、ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、この機会に是非ともご来場いただきたく、ご案内申し上げます。

敬具

会 期 1/16 (水) ~ 18 (金) 10:00~18:00 最終日17:00まで
 会 場/ブース 東京ビッグサイト 東3ホール/No. E19-7

検査対象例

MUH/MSX series : デバイス関連 (LiDAR、光デバイス、水晶デバイス、MEMSデバイス)
 超小型パッケージ、SMD、各種センサ、レーザーダイオード、LED など
MSZ series : ECU、キーレススイッチ、車載用バックカメラ、ウェアラブル端末 など

ピックアップ



小型電子部品専用 気密検査装置

MSX-6110 series

- ・ボンピング、グロス・ファインリークテストを行う
全自動検査システム
- ・漏れ判定レベル
 グロスリーク : $\sim 2 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ (等価標準リーク)
 ファインリーク : $\sim 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ (He)
- ・対象ワークサイズ 1.2×1.0~2.0×1.6mm



ウルトラファイン リークテストシステム

MUH-0100 series

- ・使用年数が長く高気密性が必要な小型電子部品の検査に最適
- ・ヘリウムガスによる超微小漏れ測定専用の装置
- ・漏れ判定レベル $\sim 4 \times 10^{-15} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
- ・最大ワークサイズ $\Phi 44 \times L31\text{mm}$ (角30×30)



密封品エアリークテスト装置

MSZ series

- ・密封品用のエアリークテスト装置
- ・抜き取り検査、完成品検査に便利
- ・検査結果を数値管理 (定量的)
- ・防水規格IPX7, 8に相当する漏れ試験